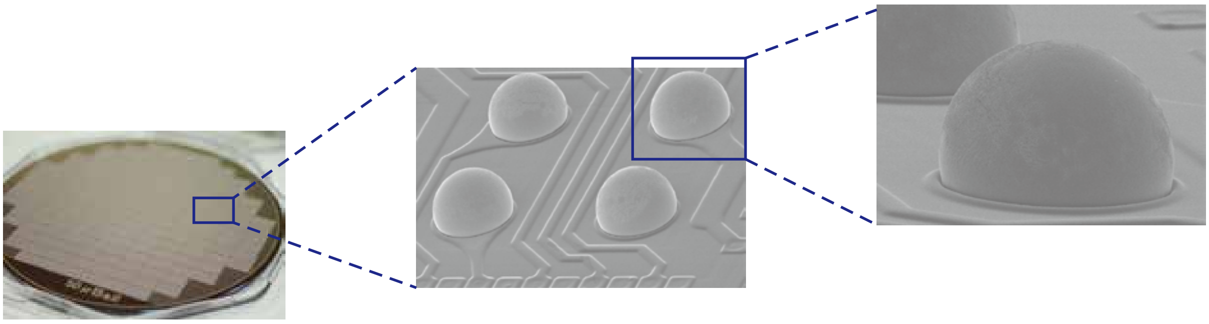
maxell

ウェハバンピングサービス
Wafer Bumping Service

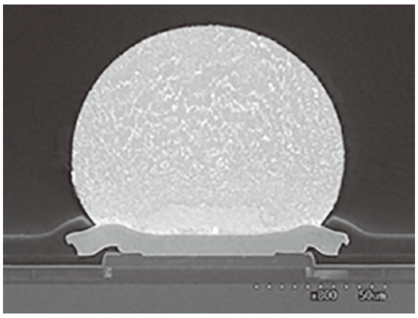
自社開発した特殊構造治具により、振込法でのソルダーボールの一括搭載を優れた歩留率で実現しました。
均一性の高いバンプ形成や、他工法と比較してソルダーボール材料の選択肢が広いのが特長です。

By using the specially-structured jig we developed, we achieved the batch placement of solder ball by ball placement method on excellent yield rate. The features are that ball placement is formed by high coplanarity and various solder balls can be selected in comparison with other methods.



特長　Features

1. マイクロソルダーボール（50μm以下）搭載可能
   Possible to place 50μm or smaller micro solder balls
2. UBM形成から受託可能
   Possible to support UBM process
3. リペア機導入により高い搭載率を実現
   High placement rate by the repairing machine
4. 電鋳技術による自社製特殊治具を使用
   Use proprietary jig by EF^2 technology
5. 短納期、低コストを実現
   Short lead time and low cost
6. ソルダーバンプ内のボイドを原理的に抑制
   Prevent voids in solder bump



ソルダーバンプの断面画像
Section view of solder bump

仕様　Specifications

		仕様 Specifications		備考 Note
マクセル加工 Maxell process	UBM方式・構造 UBM method / Structure	A) ① Ni / Au（無電解） Ni / Au (Electroless plating) B) ② Ti / Cu / Ni（スパッタ&メッキ） Ti / Cu / Ni (Sputtering & Plating)		
	ソルダーボールサイズ Solder ball size	Φ50μm以上 phi 50μm or bigger		
受け入れウェハ Acceptable wafer	サイズ Size	Φ6インチ phi 6-inch	Φ8インチ phi 8-inch	その他は応相談 As for others, asking
	厚さ Thickness	550～675μm	725μm以上 725μm or thicker	
	電極サイズ Pad size	Φ50μm相当以上 phi 50μm or bigger		
	電極ピッチ Pad pitch	100μm以上 100μm or more		100μm以下は応相談 As for 100μm or less, asking
	電極表面材質 Pad surface materials	Al or Au		

EF^2 *Electro Fine Forming*

<お問い合わせ>
マクセル株式会社　ライフソリューション事業本部
TEL：03-6407-2927
製品情報サイト　http://biz.maxell.com/ja/

マクセル　ウェハバンピングサービスカタログ
2017年10月作成